

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

中芯截至二零零八年三月三十一日止三個月業績公佈

- 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（[中芯]或[本公司]）於今日公佈截至二零零八年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。
- 非記憶體產品的銷售額與二零零七年第四季相比上升5.5%至 318,600,000 元，與二零零七年第一季相比上升 25.6%。然而總銷售額與二零零七年第四季相比下降 8.3%至 362,400,000 元，與二零零七年第一季相比下降 6.7%是由於記憶體產品出貨量減少。記憶體產品占總銷售額的百分比由二零零七年第四季的 23.6% 下降至 12.1%。來自于 0.13 微米全流程和 90 納米技術的邏輯產品的銷售額錄得季度升幅 33.5%。二零零八年第一季的毛利率為負 9.0%，相較於二零零七年第四季的 8.9%主要是來自於標準型記憶體產品業務的虧損，其中包括對剩餘記憶體存貨的損失預提 44,500,000 元。二零零八年第一季公司錄得淨虧損 119,100,000 元，其中包括反轉二零零七年第四季的遞延所得稅利益 20,500,000 元，同樣的根據美國公認會計原則要求，二零零七年的淨虧損被調整為 19,000,000 元。每股美國預托股股份淨虧損（攤薄）為 0.3205 元。
- 以下為本公司於二零零八年四月二十九日就截至二零零八年三月三十一日止三個月的未經審核業績在報章所作的報章公佈全文。
- 本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(1) 條規定的披露責任於二零零八年四月二十九日作出本公佈。

以下為本公司於二零零八年四月二十九日就截至二零零八年三月三十一日止三個月的未經審核業績在報章所作的報章公佈全文。

所有貨幣數位主要以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則厘定。

中國上海—二零零八年四月二十九日—國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（「中芯」或「本公司」）於今日公佈截至二零零八年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零零八年第一季概要

- 非記憶體產品的銷售額與二零零七年第四季相比上升5.5%至 318,600,000 元，與二零零七年第一季相比上升 25.6%。
- 然而總銷售額與二零零七年第四季相比下降 8.3%至 362,400,000 元，與二零零七年第一季相比下降 6.7%是由於記憶體產品出貨量減少。
- 記憶體產品占總銷售額的百分比由二零零七年第四季的 23.6%下降至 12.1%。
- 來自于 0.13 微米全流程和 90 納米技術的邏輯產品的銷售額錄得季度升幅 33.5%。
- 二零零八年第一季的毛利率為負 9.0%，相較於二零零七年第四季的 8.9%主要是來自於標準型記憶體產品業務的虧損，其中包括對剩餘記憶體存貨的損失預提 44,500,000 元。
- 二零零八年第一季公司錄得淨虧損 119,100,000 元，其中包括反轉二零零七年第四季的遞延所得稅利益 20,500,000 元，同樣的根據美國公認會計原則要求，二零零七年的淨虧損被調整為 19,000,000 元。
- 每股美國預托股股份淨虧損（攤薄）為 0.3205 元。

於二零零八年第一季度，本公司和我們的客戶達成協定退出標準型記憶體商品業務。本公司認為根據 SFAS 第 144 條規定中芯北京的耐用資產有減值迹象。截止本公告發佈日，本公司已經僱傭外部評估機構，並正在評估該等資產是否已經減值。一經決定，將額外增加二零零八年第一季的非現金資產減值費用。

關於本季營運成果，中芯國際總執行長張汝京博士透過電話會議向分析員們表示：“中芯國際淨虧損 1.191 億元，其中 4.45 千萬元的虧損系來自提增 DRAM 備抵存貨跌價損失之金額，以及 2.05 千萬元記錄於 2007 年第 4 季的遞延所得稅收益的沖銷。在今年第一季，公司與客戶達成共識，即完全退出標準型 DRAM 的市場，減少 DRAM 的生產及轉換 DRAM 的產能至邏輯，此一策略亦是我們 2008 年的主軸。有鑒於此，中芯國際一致的努力減少 DRAM 代工的服務並達成相較于上季減少了銷售額 53.0%及去年同期減少 67.5%的成果。同時，邏輯出貨較上季成長了 6.2%。而其中 90 納米邏輯的出貨與上季相比更竄升 136.8%。相較 2007 年第 4 季的 DRAM 占總銷售額的 23.6%，本季降至 12.1%，整體的邏輯收入季成長為 6.5%，年成長為 25.6%。

0.13 微米全流程與 90 納米的邏輯銷售額較上季成長了 33.5%。基於邏輯晶片強勁的市場需求，如移動基帶晶片、多媒體處理器、PDA、GPS、閃爍驅動晶片、電源管理晶片、MP3/MP4、數位電視錄影處理器及行動電視，預測整個 2008 年，對於高端制程的需求將持續強勢。

中國大陸目前為世界最大的集成電路市場，並從今年年初至今即呈現了強勁的市場成長。相較去年第 4 季，我們在中國的銷售額成長 22.6%，在本季新增加了 15 家國內的客戶，同時，相較于上一季，我們在新產品流片 (tape-out) 增長了 17.1%。

不僅在中國地區的銷售額有可觀的增長，而且在北美地區亦是表現亮麗。雖然美國經濟面臨著巨大的挑戰，但相較上一季，我們在北美的銷售額成長了 10.0%，占本季總收入的 53.6%，而 2007 年第 4 季則為總收入的 44.6%。

我們對於 IBM45 納米的技術許可協定的發展亦是非常滿意。目前有近 10 家頂尖的晶片設計公司與 IDM 客戶表示了與我們合作的意願。此一具有里程碑意義的協定，奠定了客戶對於中芯未來技術發展藍圖的信心，也因而為我們增加了在 65 納米與 90 納米的客戶。除此之外，亦獲至中國客戶對於 45 納米的合作興趣。我們計畫將於 2009 進入認證的階段。

我們致力於對提升投資人利益的承諾是不容置疑的，為達至此目的，將持續執行既有之計劃，加速成長，服務客戶，並提升利潤。我們對目前的策略信心十足，對未來一年非常樂觀。

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零零八年四月三十日

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：美國 1-617-597-5342 (密碼：SMIC) 或香港 852-3002-1672 (密碼：SMIC)。

二零零八年第一季業績公佈網上直播可於 www.smics.com 網站「投資者關係」一欄收聽。中芯網站在網上廣播後為期十二個月提供網上廣播錄音版本連同本新聞發佈的軟拷貝。

關於中芯

中芯國際（“SMIC”，紐約證交所股票代碼：SMI，香港恒生股票代碼：0981.HK）總部位於中國上海，是世界領先的集成電路晶片代工公司之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 65 納米及更先進的晶片製造服務。公司在上海的旗艦廠擁有一座 12 吋晶片廠及三座 8 吋晶片廠。北京旗艦廠建有兩座 12 吋晶片廠，在天津建有一座 8 吋晶片廠，在成都還建有一座封裝測試廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本提供客戶服務和設立銷售辦事處，同時在香港設立了代表處。此外，中芯國際受委託經營管理成都成芯半導體製造有限公司的一座 8 吋晶片廠，以及武漢新芯集成電路製造有限公司的一座 12 吋晶片廠。詳細資訊請參考中芯國際網站 <http://www.smics.com>

安全港聲明

（根據 1995 私人有價證券訴訟改革法案）

本次新聞發佈可能載有（除歷史資料外）依據1995美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括我們對於二零零八年第二季銷售額的預期，我們對於在二零零八年餘下的時間裏針對高端制程的需求將持續強勢的預期，對於邏輯晶片強勁的市場需求的預期，我們計劃於二零零九年進入45納米認證階段的預期，中芯於二零零八年加強和改善盈利能力，以及在隨後“資本概要”和“二零零八年第二季”指引中的聲明乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「計劃」、「估計」、「預計」、「預測」及類似表述為該等前瞻性陳述之標識，儘管並非所有前瞻性陳述均包含上述字眼。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知風險、不確定性，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，包括（但不限於）與半導體行業周期及市場狀況有關的風險、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯量產新產品的能力、半導體代工服務供求情況、行業產能過剩、設備、零件及原材料短缺、製造生產量供給及最終市場的金融局勢是否穩定。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會（「證交會」）的文件資料，包括其於二零零七年六月二十九日以 20-F 表格形式呈交予證交會的經修訂的年度報告，特別是「風險因素」及「有關財政狀況及經營業績的管理層討論及分析」兩個部份，以及中芯可能不時向證交會及香港聯交所呈交的該等其他文件，包括 6-K 表格。其他未知或不可預知的因素亦可能會對中芯日後的業績、表現或成就造成重大不利影響。鑒於上述風險、不確定性、假設及因素，本新聞發佈中提及的前瞻性事件可能不會發生。務請閣下注意，切勿過份依賴此等前瞻性陳述，此等陳述僅就本新聞發佈中所載述日期（或如無有關日期，則為本新聞發佈日期）的情況而表述。除法律有所規定以外，中芯概不就因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況承擔任何責任，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

重大訴訟

台積電法律訴訟之近期發展

二零零六年八月二十五日，台積電入稟加州阿拉米達郡最高法院，就指稱本公司違反和解協議、違反承兌票據及不當使用商業機密而對本公司及若干附屬公司（中芯上海、中芯北京及中芯美國）提出訴訟。台積電訴求（其中包括）損害賠償、禁制令、律師費及提早支付和解協議項下尚未支付之金額。

在當前之訴訟中，台積電指稱本公司將台積電之商業機密運用於製造本公司0.13微米或更小之工藝產品。台積電進一步稱，由於本公司違約，有關台積電之專利牌照已予終止而有關本公司較大工藝產品之不起訴契約已失效。

本公司強烈否認所有不當使用之指控。法院並無證據證明台積電之索償屬有效，亦未確定審判日期。

本公司於二零零六年九月十三日公佈，除提出強烈抗辯台積電在美國訴訟提出的指控外，本公司已於二零零六年九月十二日反訴台積電，就（其中包括）台積電違反合約及違反默示的真實公平交易的契諾，要求台積電作出損害賠償。

中華人民共和國北京市高級人民法院於二零零六年十一月十六日受理本公司及本公司的全資子公司中芯上海及中芯北京共同提起的針對台積電違反誠實信用原則、商業詆毀的不公平競爭行為的指控（「中國訴訟」）。在中國訴訟中，本公司尋求（其中包括）判令台積電停止侵權行為、台積電公開向本公司道歉和賠償（包括台積電因其侵權行為所獲得的利潤）。

台積電於二零零七年一月向美國加州法院動議尋求禁制中國訴訟。於二零零七年二月，台積電向北京市高級人民法院提出司法管轄權的異議，質疑北京市高級人民法院對中國訴訟的司法管轄權限。

二零零七年三月，加州法院駁回台積電有關禁制中國訴訟的動議，台積電就加州法院的判決上訴。於二零零八年三月二十六日，上訴法院以書面形式否認台積電的上訴。台積電尚未表示其會否呈請加州最高法院作進一步審核。

於二零零七年七月，北京市高級人民法院駁回台積電對中國訴訟的司法管轄權的異議並認為北京市高級人民法院擁有適當的司法管轄權審理該訴訟。台積電就北京市高級人民法院的判決，向中華人民共和國最高人民法院提出上訴。於二零零八年一月七日，最高法院審理了台積電的訴訟，惟尚未作出判決。

二零零七年八月十四日，本公司修訂對台積電提出的反訴，尋求（其中包括）台積電違約及違反專利許可協議的賠償。台積電隨後否認本公司關於修正反訴的指稱，並追加指稱本公司於北京市高級人民法院起訴台積電乃違反和解協定，經本公司之聲請，加州法院依程序不適當排除此新的指稱，但同意台積電依適當程序重新主張。本公司其後抗訴新的申索為再申辯。法院維持部份本公司抗訴，惟再次給予台積電許可再申辯。

於二零零七年八月十五日至十七日，美國加州法院就台積電申請臨時禁制令欲禁止本公司製造或分銷特定的0.13微米或以下的邏輯技術產品作出聆訊。法院在二零零七年九月七日作出裁定。該裁定拒絕台積電提出的臨時禁制令申請，因而本公司的業務發展和銷售得以不受影響。但該裁定要求本公司若計劃在某些情況下披露其邏輯技術予非中芯國際的機構時，必須給予台積電十天的事先通知以讓台積電可就該披露提出反對。

於二零零八年一月二十五日，台積電就本公司多宗交相申索向加州法院呈交一份向本公司作出的循簡易程序判決的動議。本公司將反對該動議。聆訊將於二零零八年五月三十日就動議召開。

於二零零八年三月十一日，台積電呈交一份於加州法院附加命令的申請。藉該申請，台積電

尋求取得與本公司就和解協議而發出的承兌票據餘下結餘等值金額的命令。倘授出該命令，將僅適用於本公司在加州的財產。本公司已反對該項申請。聆訊已於二零零八年四月三日召開。法院尚未作出裁定。

根據美國財務會計準則第 144 號，本公司須決定該未決訴訟是否構成需要進一步分析專利許可組合是否已受損害之事件。我們相信，該法律訴訟現處於初步階段，我們仍在評估訴訟是否屬於該類事件。本公司預期將獲得進一步資料以協助我們做出決定。根據美國財務會計準則第 144 號進行之任何損害分析結果可能對本公司財政狀況及經營業績產生重大影響。由於訴訟仍處於初步階段，本公司未能評估頒佈不利判決的可能性或評估潛在虧損的金額或範圍。

投資者聯絡資料：

Theresa Teng
電話：+86-21-5080-2000，內線： 16278
theresa_teng@smics.com

Phyllis Liu
電話：+86-21-5080-2000，內線： 12315
phyllis_liu@smics.com

Anne Wong Chen
電話：+86-21-5080-2000，內線： 12804
Anne_Wong_Chen@smics.com

二零零八年第一季經營業績概要：

以千美元為單位（每股盈利和百分比除外）

	二零零八年 第一季度	二零零七年 第四季度	季度比較	二零零七年 第一季度	年度比較
銷售收入	362,369	395,254	-8.3%	388,284	-6.7%
銷售成本	394,940	360,207	9.6%	351,345	12.4%
毛利	(32,571)	35,047	-	36,940	-
經營開支	64,377	57,389	12.2%	21,722	196.4%
經營收益（虧損）	(96,948)	(22,342)	333.9%	15,218	-
其他收入（支出），淨額	(3,596)	(1,655)	117.3%	(12,187)	-70.5%
所得稅利益（支出）	(19,142)	23,100	-	5,964	-
稅後淨收入（虧損）	(119,685)	(897)	13242.8%	8,995	-
少數股權	846	1,157	-26.9%	977	-13.4%
應占聯營公司虧損	(241)	(882)	-72.7%	(1,212)	-80.1%
普通股持有人應占收入（虧損）	(119,081)	(622)	19044.9%	8,760	-
毛利率（遞延成本調整前）					
毛利率	-9.0%	8.9%		9.5%	
經營利潤率	-26.8%	-5.7%		3.9%	
每股普通股股份淨收入（虧損）-基本 ⁽¹⁾	(0.0064)	(0.0000)		0.0005	
每股美國預托股股份淨收入（虧損）-基本	(0.3205)	(0.0017)		0.0237	
每股普通股股份淨收入（虧損）-攤薄 ⁽¹⁾	(0.0064)	(0.0000)		0.0005	
每股美國預托股股份淨收入（虧損）-攤薄	(0.3205)	(0.0017)		0.0234	
付運晶圓（8吋等值） ⁽²⁾	454,259	497,454	-8.7%	450,592	0.8%
產能使用率	92.1%	94.4%		86.2%	

附注：

(1) 基於二零零八年第一季加權平均普通股 18,579,000,000 股（基本）及 18,579,000,000 股（攤薄），二零零七年第四季度 18,550,000,000 股（基本）及 18,550,000,000 股（攤薄），二零零七年第一季度 18,451,000,000 股（基本）及 18,706,000,000 股（攤薄）。

(2) 包括銅接連件

- 非記憶體產品的銷售額與二零零七年第四季相比上升5.5%至 318,600,000 元，與二零零七年第一季相比上升 25.6%。
- 然而二零零八年第一季的總銷售額與二零零七年第四季的 395,300,000 元相比下降8.3%至 362,400,000 元，與二零零七年第一季的 388,300,000 元相比下降 6.7%是由於記憶體產品出貨量減少。
- 二零零八年第一季的銷售成本與二零零七年第四季的 360,200,000 元相比上升 9.6%至 394,900,000 元，主要由於額外預提了 44,500,000 元的剩餘記憶體產品存貨的跌價損失準備。
- 二零零八年第一季的毛利與二零零七年第四季的 35,000,000 元相比下降至負 32,600,000 元，二零零七年第一季的毛利為 36,900,000 元。
- 二零零八年第一季的毛利率由二零零七年第四季的 8.9%下降至負 9.0%，主要是來自於標準型記憶體產品業務的虧損。
- 二零零八年第一季的總經營開支由二零零七年第四季的 57,400,000 元上升至 64,400,000 元，錄得季度升幅 12.2%，主要由於研發費用增加所致。
- 二零零八年第一季的研發費用由二零零七年第四季的 26,200,000 元上升 30.7%至 34,200,000 元主要由於上海新的 12 英寸廠的啟動費用增加所致。
- 二零零八年第一季的一般行政費用由二零零七年第四季的 18,800,000 元下降至 18,600,000 元。
- 二零零八年第一季的銷售費用由二零零七年第四季的 5,700,000 元下降 14.1%至 4,900,000 元，主要由於與銷售行為相關的工程材料耗用下降所致。

收入分析：

銷售分析			
	二零零八年 第一季度	二零零七年 第四季度	二零零七年 第一季度
以應用分類			
電腦	12.8%	22.9%	33.0%
通訊	54.3%	47.4%	41.3%
消費	25.9%	22.7%	18.3%
其他	7.0%	7.0%	7.4%
以服務分類			
邏輯 ⁽³⁾	78.4%	67.4%	58.2%
記憶	12.1%	23.6%	34.7%
管理服務	2.5%	1.5%	3.2%
光罩製造，探測及其它	7.0%	7.5%	3.9%
以客戶類別分類			
	二零零八年 第一季度	二零零七年 第四季度	二零零七年 第一季度

非廠房半導體公司	54.4%	49.3%	47.1%
集成裝置製造商	31.6%	38.5%	43.2%
系統公司及其它	14.0%	12.2%	9.7%
以地區分類	二零零八年 第一季度	二零零七年 第四季度	二零零七年 第一季度
北美洲	53.6%	44.6%	40.6%
亞太區（不包括日本）	29.9%	26.4%	24.2%
日本	3.9%	10.4%	9.9%
歐洲	12.6%	18.6%	25.2%
晶圓收入分析			
各技術占晶圓銷售額的百分比（僅包括邏輯、 記憶及銅接連件）	二零零八年 第一季度	二零零七年 第四季度	二零零七年 第一季度
0.09 微米	19.8%	25.3%	14.4%
0.13 微米	25.0%	24.4%	38.1%
0.15 微米	4.2%	5.5%	2.9%
0.18 微米	32.1%	28.3%	34.1%
0.25 微米	0.5%	0.5%	0.7%
0.35 微米	18.4%	16.0%	9.8%
各邏輯技術占邏輯晶圓銷售額百分比⁽¹⁾	二零零八年 第一季度	二零零七年 第四季度	二零零七年 第一季度
0.09 微米	14.7%	7.7%	10.0%
0.13 微米 ⁽²⁾	20.3%	21.0%	17.6%
0.15 微米	5.0%	7.7%	4.7%
0.18 微米	37.8%	40.3%	50.1%
0.25 微米	0.5%	0.6%	1.0%
0.35 微米	21.7%	22.7%	16.6%

附注：

- (1) 不包括 0.13 微米銅接連件
- (2) 代表來自于全流程製造晶圓的銷售收入
- (3) 包括 0.13 微米銅接連件

產能：

廠／（晶圓尺寸）	二零零八年 第一季度*	二零零七年 第四季度*
上海廠（8吋） ⁽¹⁾	88,000	98,000
北京廠（12吋） ⁽²⁾	54,000	65,250
天津廠（8吋）	25,396	22,000
每月晶圓裝配總產能	167,396	185,250

附注：

* 期終每月晶圓計 8 吋等值

(1) 上海廠目前包括晶圓一廠，晶圓二廠和晶圓三廠

(2) 北京廠目前包括晶圓四廠，晶圓五廠和晶圓六廠

- 截至二零零八年第一季度末，每月產能下降至 167,396 片 8 吋等值晶圓是由於記憶體產品轉換為邏輯產品的產品組合的更換。

付運及使用率：

8 吋等值晶圓	二零零八年 第一季度	二零零七年 第四季度	二零零七年 第一季度
付運晶圓（包括銅接連件）	454,259	497,454	450,592
使用率(1)	92.1%	94.4%	86.2%

附注：

(1) 產能使用率按輸出晶圓總額除以估計產能計算

- 二零零八年第一季晶圓付運數量較二零零七年第四季的 497,454 片 8 吋等值晶圓下降 8.7%至 454,259 片 8 吋等值晶圓，較二零零七年第一季度的 450,592 片 8 吋等值晶圓分錄得年度升幅 0.8%，主要由於記憶體產品的出貨量下降。
- 然而，二零零八年第一季邏輯產品的出貨量增加至 334,432 片 8 吋等值晶圓，較二零零七年第四季與二零零七年第一季度，分別錄得季度升幅 6.2%及年度升幅 38.0%。

詳細財務分析

毛利分析：

以千美元計	二零零八年 第一季度	二零零七年 第四季度	季度比較	二零零七年 第一季度	年度比較
銷售成本	394,940	360,207	9.6%	351,345	12.4%
折舊	159,715	161,232	-0.9%	185,707	-14.0%
其他製造成本	227,731	190,671	19.4%	157,279	44.8%
遞延成本攤銷	5,886	5,886	-	5,886	-
股權報酬	1,608	2,418	-33.5%	2,473	-35.0%
毛利	(32,571)	35,047	-	36,940	-
毛利率	-9.0%	8.9%		9.5%	

- 二零零八年第一季的銷售成本與二零零七年第四季的 360,200,000 元相比上升 9.6%至 394,900,000 元，主要由於額外預提了 44,500,000 元的剩餘記憶體產品存貨的跌價損失準備。
- 二零零八年第一季的毛利與二零零七年第四季的 35,000,000 元相比下降至負 32,600,000 元，二零零七年第一季的毛利為 36,900,000 元。
- 二零零八年第一季的毛利率由二零零七年第四季的 8.9%下降至負 9.0%，主要是來自於標準型記憶體產品業務的虧損。

經營開支分析

以千美元計	二零零八年 第一季度	二零零七年 第四季度	季度比較	二零零七年 第一季度	年度比較
總經營開支	64,377	57,389	12.2%	21,722	196.4%
研究及開發	34,233	26,201	30.7%	21,733	57.5%
一般及行政	18,606	18,820	-1.1%	17,087	8.9%
銷售及市場推廣	4,883	5,688	-14.1%	3,893	25.4%
無形資產攤銷	6,784	6,878	-1.4%	6,229	8.9%
資產處置收入	(130)	(198)	-34.3%	(27,220)	-99.5%

- 二零零八年第一季的總經營開支由二零零七年第四季的 57,400,000 元上升至 64,400,000 元，錄得季度升幅 12.2%，主要由於研發費用增加所致。
- 二零零八年第一季的研發費用由二零零七年第四季的 26,200,000 元上升 30.7%至 34,200,000 元主要由於上海新的 12 英寸廠的啓動費用增加所致。

- 二零零八年第一季的一般行政費用由二零零七年第四季的 18,800,000 元下降至 18,600,000 元。
- 二零零八年第一季的銷售費用由二零零七年第四季的 5,700,000 元下降 14.1% 至 4,900,000 元，主要由於與銷售行為相關的工程材料耗用下降所致。

其他收入（支出）：

以千美元計	二零零八年 第一季度	二零零七年 第四季度	季度比較	二零零七年 第一季度	年度比較
其他收入(支出)	(3,596)	(1,655)	117.3%	(12,187)	-70.5%
利息收入	3,758	3,971	-5.4%	1,972	90.6%
利息支出	(17,267)	(11,485)	50.3%	(15,003)	15.1%
其他，淨額	9,913	5,859	69.2%	844	1074.5%

- 二零零八年第一季的其他非經營性損失為 3,600,000 元，二零零七年第四季為 1,700,000 元，主要由於利息費用增加所致。
- 二零零八年第一季的利息費用相較於二零零七年第四季有所增加，是由於二零零八年第一季的利息資本化金額減少以及於二零零七年第四季收到政府的利息補貼所致。
- 其他，淨額增加是由於與非經營性活動相關的匯兌收益增加所致。

流動資金：

以千美元計	二零零八年 第一季度	二零零七年 第四季度
現金及現金等價物	506,320	469,284
短期投資	29,474	7,638
應收賬款	283,932	298,388
存貨	216,159	248,310
其他	59,036	51,682
流動資產總計	1,094,921	1,075,302
應付賬款	290,677	301,993
短期借款	137,470	107,000
長期借款的即期部份	341,620	340,693
其他	181,054	180,504
流動負債總計	950,821	930,190
現金比率	0.5x	0.5x
速動比率	0.9x	0.8x

流動比率	1.2x	1.2x
------	------	------

資本結構：

以千美元計	二零零八年 第一季度	二零零七年 第四季度
現金及現金等價物	506,320	469,284
短期投資	29,474	7,638
長期票據即期部分	29,493	29,242
長期票據	51,495	51,057
短期借款	137,470	107,000
長期借款的即期部份	341,620	340,693
長期借款	639,058	616,295
總借款	1,118,148	1,063,988
股東權益	2,897,407	3,012,519
總借款對權益比率	38.6%	35.3%

現金流量概要

以千美元計	二零零八年 第一季度	二零零七年 第四季度
來自於經營活動的現金淨額	136,231	195,872
來自於投資活動的現金淨額	(153,727)	(266,780)
來自於融資活動的現金淨額	54,594	101,946
現金變動淨額	37,036	31,022

- 二零零八年第一季來自於經營活動的現金淨額有所下降是由於較高的經營虧損以及向原材料供應商支付較多的貨款。

資本開支概要

- 二零零八年第一季資本開支為 136,000,000 元。
- 計劃下的二零零八年資本開支總額將約為 700,000,000 元，並且將根據市場狀況作調整。

二零零八年第二季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已于之前的安全港聲明中闡明。

- 銷售額預期比二零零八年第一季度下降 3%-6%，然而非記憶體產品的銷售額預期比二零零八年第一季度成長 3%-6%。
- 經營開支相對銷售的百分比預期為 20%左右。
- 資本開支預期約介於 160,000,000 元至 200,000,000 元之間。

近期公佈

- 二零零七年年度業績公佈（二零零八年四月二十五日）
- 股票價格不尋常波動（二零零八年四月十五日）
- 合資格會計師豁免延期（二零零八年四月七日）
- 美國南方衛理公會大學祝賀列入工程領袖館的三位元傑出校友（二零零八年三月二十八日）
- 業務最新發展（二零零八年三月二十四日）
- 中芯國際參加 SEMICON China 2008（二零零八年三月十八日）
- 中芯國際獲頒 SEMI China 社會貢獻獎；張汝京博士獲頒產業卓越貢獻獎（二零零八年三月十八日）
- 新思科技與中芯國際攜手推出增強型 90 納米參考流程以降低積體電路的設計和測試成本（二零零八年二月二十六日）
- 中芯國際張汝京博士被《半導體國際》評為二零零七年度人物（二零零八年二月二十五日）
- 進一步公告-關於須予披露交易中須披露資料的豁免申請（二零零八年二月十三日）
- 進一步延遲寄發有關須予披露交易之通函（二零零八年一月二十九日）
- 中芯截至二零零七年十二月三十一日止三個月業績公佈（二零零八年一月二十四日）

上述公佈詳情請參閱中芯網站。

http://www.smics.com/website/enVersion/Press_Center/pressRelease.jsp

合并資產負債表
(美元)

截至以下日期止

	二零零八年 三月三十一日 (未經審核)	二零零七年 十二月三十一日 (未經審核)
資產		
流動資產：		
現金及現金等價物	506,320,313	469,284,013
短期投資	29,473,900	7,637,870
應收賬款，已扣除撥備（二零零八年三月三十一日為4,084,646元，二零零七年十二月三十一日為4,492,090元）	283,931,518	298,387,652
存貨	216,159,019	248,309,765
預付款項及其它流動資產	38,642,090	31,237,755
廠房、機台及其它固定資產銷售應收款	17,355,300	17,321,000
待售資產	3,038,345	3,123,567
流動資產合計	1,094,920,485	1,075,301,622
土地使用權，淨額	57,242,556	57,551,991
廠房及設備，淨額	3,136,116,825	3,202,957,665
購入無形資產，淨額	226,440,883	232,195,132
遞延成本	64,750,835	70,637,275
股權投資	9,655,431	9,896,398
其他長期預付款	2,893,411	2,988,404
遞延稅資產	38,102,589	56,915,172
資產合計	4,630,123,015	4,708,443,659
負債及股東權益		
流動負債：		
應付帳款	290,676,671	301,992,739
預提費用及其它流動負債	151,044,251	150,109,963
短期借款	137,470,000	107,000,000
長期票據的即期部份	29,492,873	29,242,000
長期借款的即期部份	341,620,480	340,692,788
應付所得稅	516,451	1,152,630
流動負債合計	950,820,726	930,190,120
長期負債：		

長期票據	51,495,193	51,057,163
長期借款	639,058,040	616,294,743
與特許權協定相關的長期應付款	56,778,942	62,833,433
遞延稅負債	464,837	604,770
長期負債合計	747,797,012	730,790,109
負債合計	1,698,617,738	1,660,980,229
少數股權	34,098,639	34,944,408
股東權益：		
普通股，面值 0.0004 元，法定股份為 50,000,000,000 股，截止二零零八年三月三十一日已發行股份為 18,583,994,474 股，截止二零零七年十二月三十一日已發行的股份為 18,558,919,712 股。		
額外繳入股本	7,433,598	7,423,568
累計其他綜合虧損	3,317,395,859	3,313,375,972
累計虧絀	(63,647)	(1,881)
	(427,359,172)	(308,278,637)
所有股東權益合計	2,897,406,638	3,012,519,022
總負債及股東權益合計	4,630,123,015	4,708,443,659

合并營運報表
(美元)

	二零零八年 三月三十一日 (未經審核)	二零零七年 十二月三十一日 (未經審核)
銷售額	362,368,556	395,253,703
銷售成本	394,939,583	360,206,661
毛利	(32,571,027)	35,047,042
經營費用：		
研究和開發	34,232,685	26,201,351
一般及行政	18,605,813	18,820,136
銷售和市場推廣	4,883,475	5,687,731
購入無形資產攤銷	6,784,250	6,877,899
來自廠房設備和其他固定資產的銷售損失(所得)	(129,573)	(198,339)
經營費用總額	64,376,650	57,388,778
經營虧損	(96,947,677)	(22,341,736)
其他收入(支出)：		
利息收入	3,758,119	3,970,874
利息支出	(17,266,845)	(11,485,321)
匯兌收益(虧損)	10,317,302	4,613,449
其他收入(支出)，淨額	(404,404)	1,245,531
其他收入(支出)，淨額	(3,595,828)	(1,655,467)
所得稅、少數股權及股權投資虧損前淨虧損	(100,543,505)	(23,997,203)
所得稅利益(費用)	(19,141,832)	23,100,005
少數股權	845,769	1,157,102
股權投資虧損	(240,967)	(881,518)
淨虧損	(119,080,535)	(621,614)
每股股份淨虧損，基本	(0.0064)	(0.0000)

每股美國預托股份淨虧損，基本	(0.3205)	(0.0017)
每股股份淨虧損，攤薄	(0.0064)	(0.0000)
每股美國預托股份淨虧損，攤薄	(0.3205)	(0.0017)
用作計算基本每股普通股 虧損額的股份	18,579,292,515	18,550,143,535
用作計算攤薄每股普通股 虧損額的股份	18,579,292,515	18,550,143,535

* 遞延股票報酬攤銷乃關於：

銷售成本	1,607,766	2,417,679
研究和開發	802,241	975,621
一般管理	838,991	1,158,530
銷售和市場推廣	347,630	432,672

合并现金流量表
(美元)

	二零零八年 三月三十一日 (未經審核)	二零零七年 十二月三十一日 (未經審核)
經營活動:		
淨虧損	(119,080,535)	(621,614)
淨虧損至經營活動所得(所耗)現金淨額對賬的調整:		
少數股權	(845,769)	(1,157,102)
遞延稅	18,672,650	(22,072,574)
處置廠房及設備損失(收益)	(129,573)	(198,339)
折舊及攤銷	191,728,933	180,926,964
購入無形資產攤銷	6,784,250	6,877,899
股權報酬	3,596,628	4,984,502
長期票據非現金利息費用	2,073,335	1,308,496
股權投資虧損	240,967	881,518
營運資產及負債的變動:		
應收賬款, 淨額	14,456,133	9,632,506
存貨	32,150,746	6,564,937
預付款及其它流動資產	(7,309,344)	(9,940,469)
應付賬款	(16,094,831)	37,912,146
預提費用及其它流動負債	10,623,203	(18,039,712)
應付所得稅	(636,179)	(1,187,548)
經營活動所得現金淨額	136,230,614	195,871,610
投資活動:		
購入廠房及設備	(114,217,902)	(238,379,890)
處置廠房及設備所得款項	484,943	35,195,311
出售待售資產所得款項	690,161	9,075,076
購買所獲無形資產	(18,848,000)	(79,704,504)
購買短期投資	(41,975,501)	(42,590,425)
出售短期投資	20,139,472	49,624,851
投資活動所耗現金淨額	(153,726,827)	(266,779,581)
融資活動:		
短期借款所得款項	72,050,000	77,658,000
長期借款所得款項	23,690,989	249,509,832

償還長期票據支付的款項	-	(15,000,000)
償還長期借款支付的款項	-	(170,357,288)
償還短期借款支付的款項	(41,580,000)	(40,658,000)
行使雇員購股權所得款項	433,289	814,965
回購限制普通股	-	(21,500)
融資活動所得（所耗）現金淨額	54,594,278	101,946,009
匯率變動的影響	(61,765)	(16,076)
現金及現金等價物增加淨額	37,036,300	31,021,962
現金及現金等價物－期間開始	469,284,013	438,262,051
現金及現金等價物－期間結束	506,320,313	469,284,013

於本公佈刊發日期，本公司董事分別有董事會主席兼獨立非執行董事王陽元先生、本公司總裁、首席執行官兼執行董事張汝京先生、本公司非執行董事汪正綱先生、以及本公司獨立非執行董事徐大麟先生、川西剛先生、蕭崇河先生、陳立武先生、虞有澄先生及江上舟先生。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
首席執行官
張汝京

中國上海，二零零八年四月二十九日

* 僅供識別